



志聖工業

C SUN MFG Inc.,

Investor Meeting, Citi Corporate Day 2025



G2C+

T STRATEGY ALLIANCE

GPM 均豪

c sun 志聖

GMM 均華

Market Leader

Close to leading
Customers

Technological
Innovation

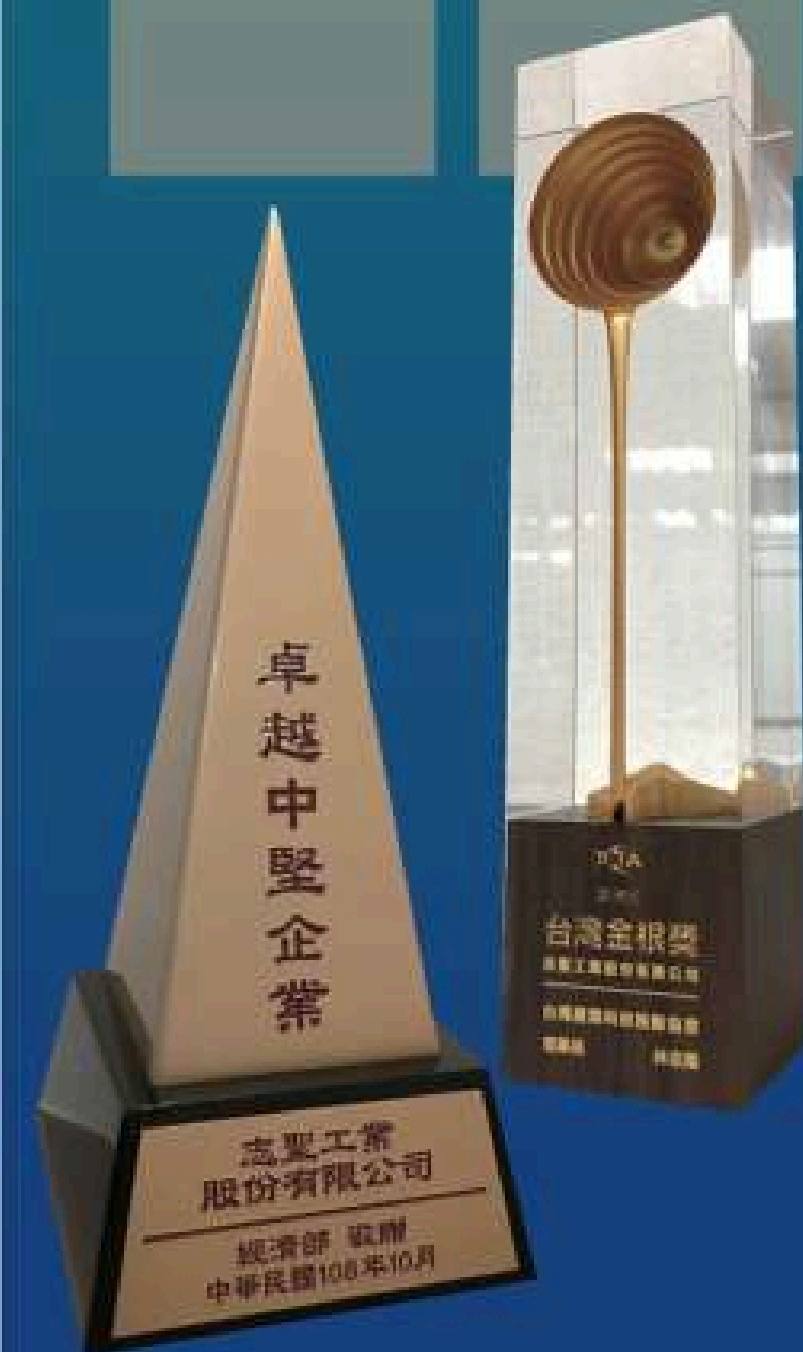
『 Management is Coordination 』

--- Dr. Dah-Hsian Seetoo ---

『 The New Paradigm Shift 』

Competition oriented	➡	Co-prosperity & symbiosis
Barrier shielding	➡	Alliance & Sharing
Product Service	➡	Eco-system Value Creating
Single Play	➡	Leverage

--- Dr. Yi-Chia Chiu ---



聯盟總人數：1700+



R&D 人數：560+

R&D佔聯盟總人數比例達 32.5%



***c sun* 志聖**

Thermal (熱)
Bonder (壓合)
Lamination (貼膜)
Peeling (撕膜)
UV/Plasma (光/電漿)

GPM 均豪精密

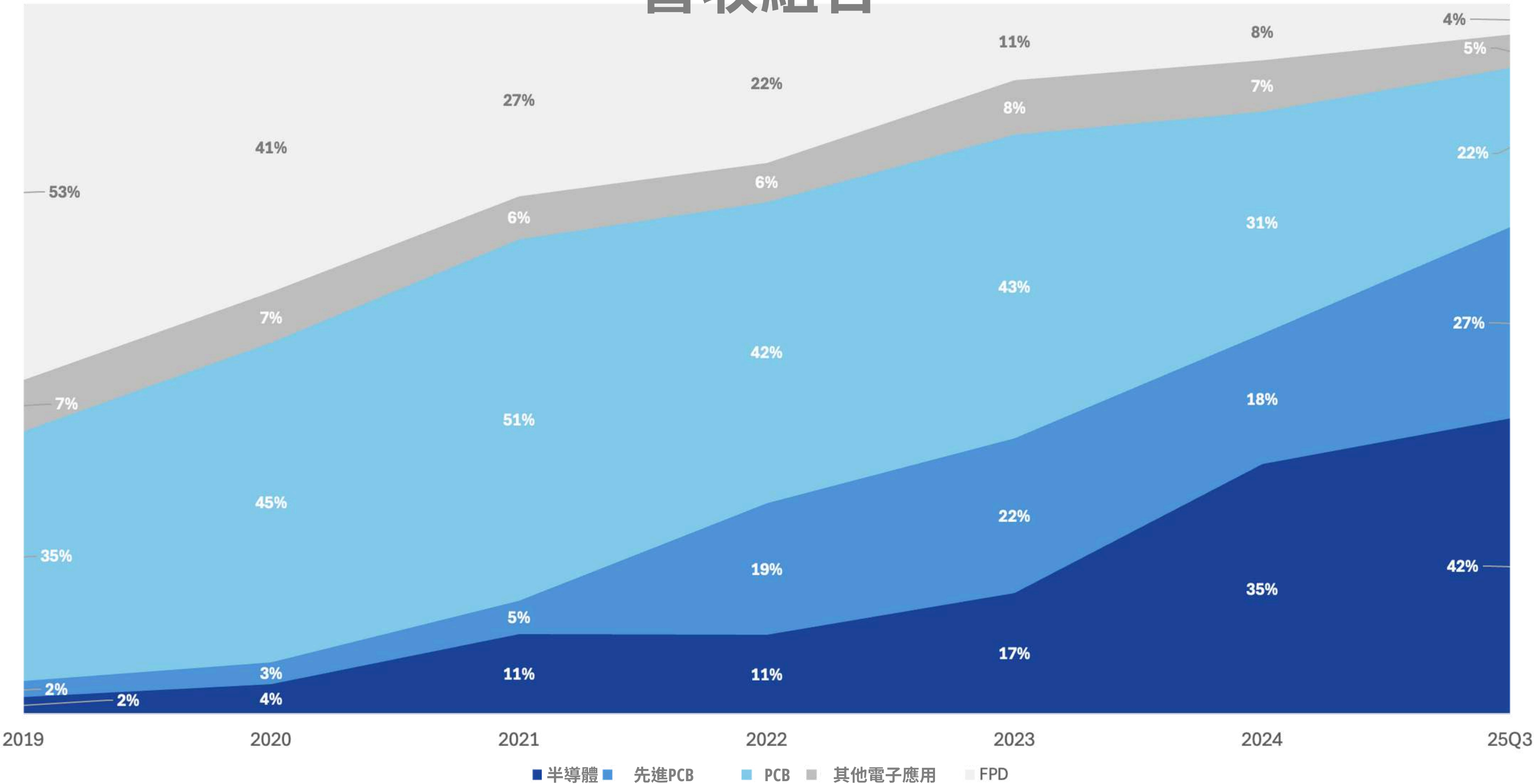
AOI (檢測)
Metrology (量測)
Grinding (研磨)
Polishing (拋光)

GMM 均華精密

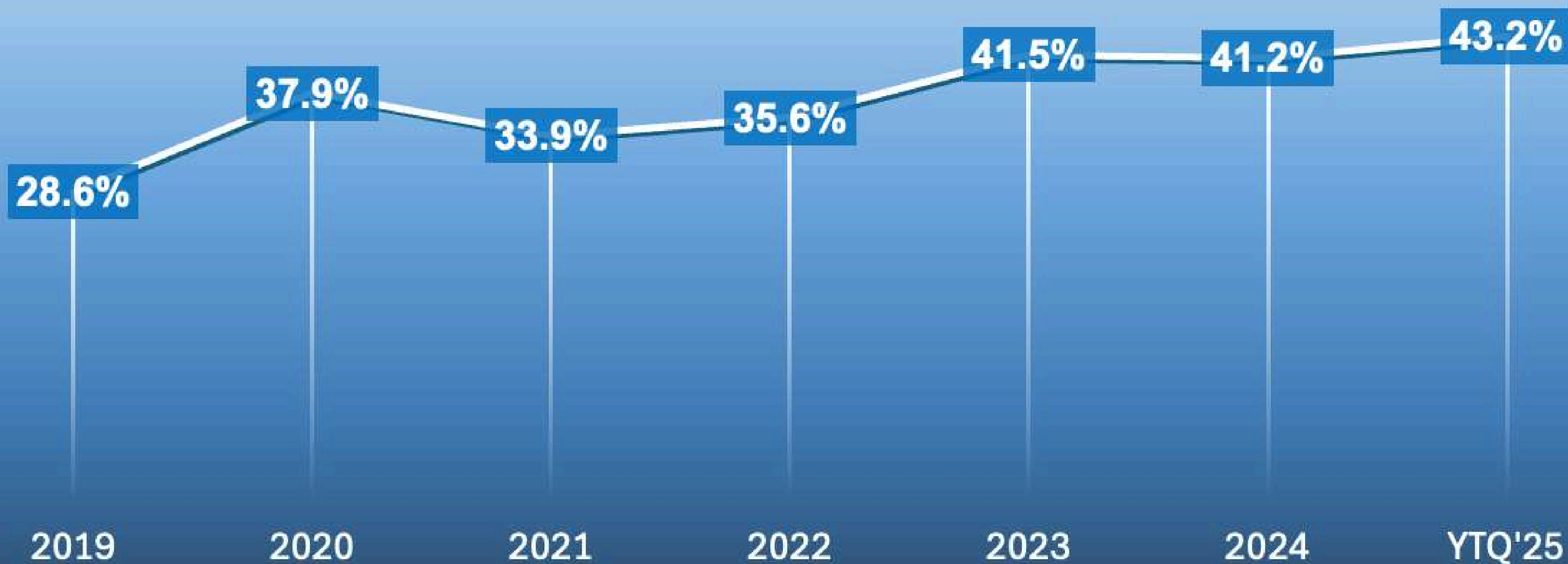
Die Attach (黏晶)
Chip Sorter (揀晶)
Auto Jig Saw (切單挑揀)

Core Technologies & Alliance Synergy

營收組合



毛利率



財務資訊摘要

綜合損益表項目

(除另予註明者外，金額為新台幣百萬元)

	3Q25	2Q25	3Q24	QoQ	YoY
營業收入淨額	1,536	1,510	1,054	1.7%	45.8%
營業毛利率%	44.2%	41.8%	42.2%	+2.4ppts	+2.0ppts
營業費用	(526)	(358)	(364)	47.0%	44.7%
營業費用率%	34.3%	23.7%	34.5%	+10.6ppts	-0.2ppts
營業利益率%	10.0%	18.1%	7.7%	-8.1ppts	+2.3ppts
營業外收入與支出	134	(5)	117	2411.2%	14.4%
歸屬予母公司業主之本期淨利	212	207	165	2.1%	28.2%
純益率%	13.8%	13.7%	15.7%	+0.1ppts	-1.9ppts
每股盈餘(新台幣元)	1.4	1.37	1.1	2.2%	27.3%

跨足 AI 產業

AI 晶片高效能運算

IC 載板

- 壓合
- 真空壓合
- ABF 剝離機

載板

HBM

高頻寬記憶體

HBM 封裝

- 自動烤箱

先進封裝

2.5D/ 3D 積體電路
晶片-晶圓-載板封裝

- 壓合
- 鍵合機
- 自動烤箱
- 紫外線固化

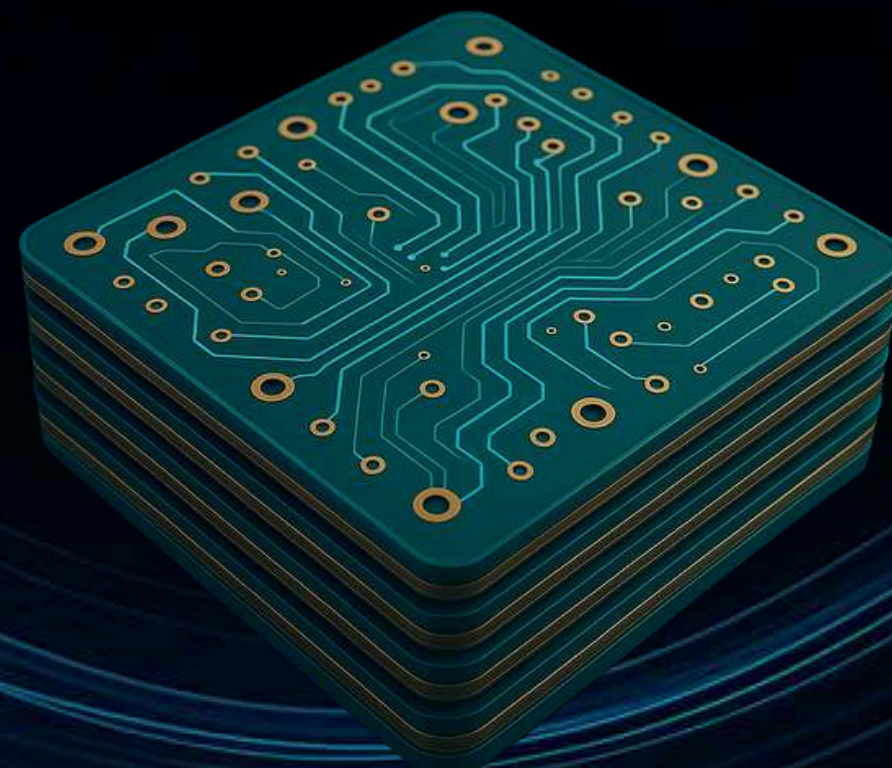


來自CPU, OAM, UBB 高密度多層板應用持續增長

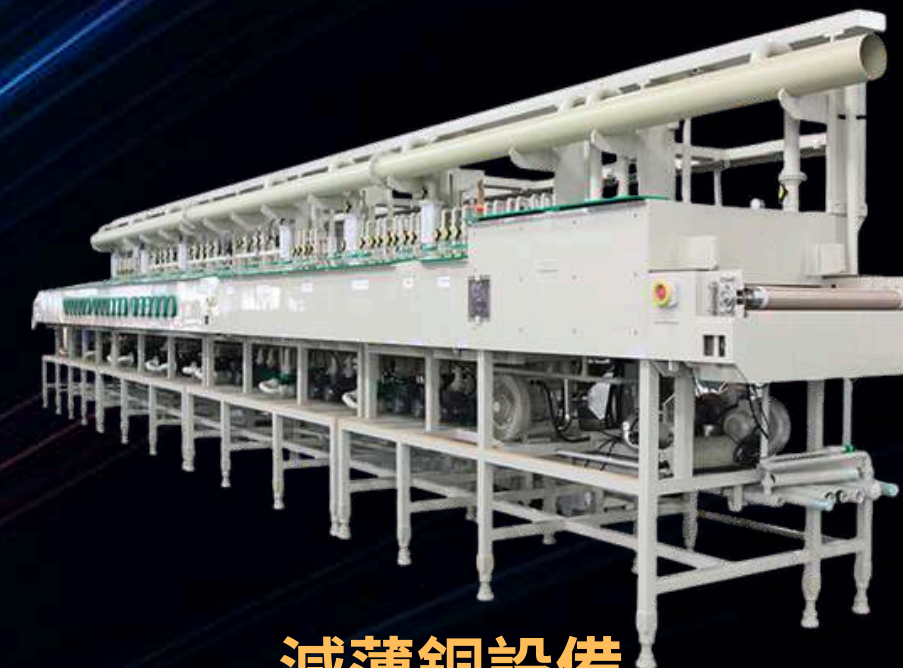
自動化烤箱



水平化學錫設備



csun 志聖 **tcf** 創峰
TOP CREATION



減薄銅設備

自動化撕膜機



化學前處理設備



壓膜機



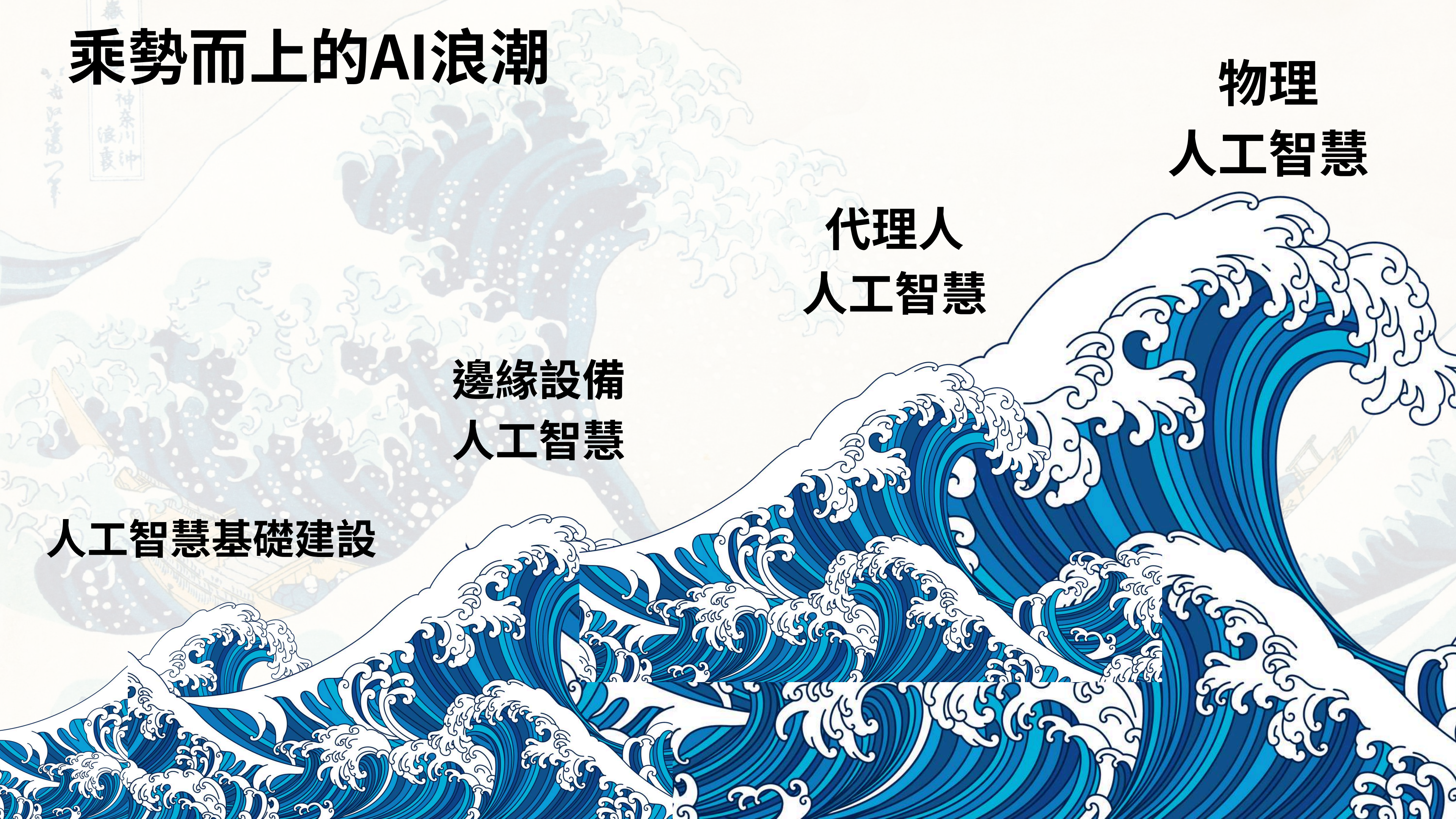
乘勢而上的AI浪潮

物理
人工智能

代理人
人工智能

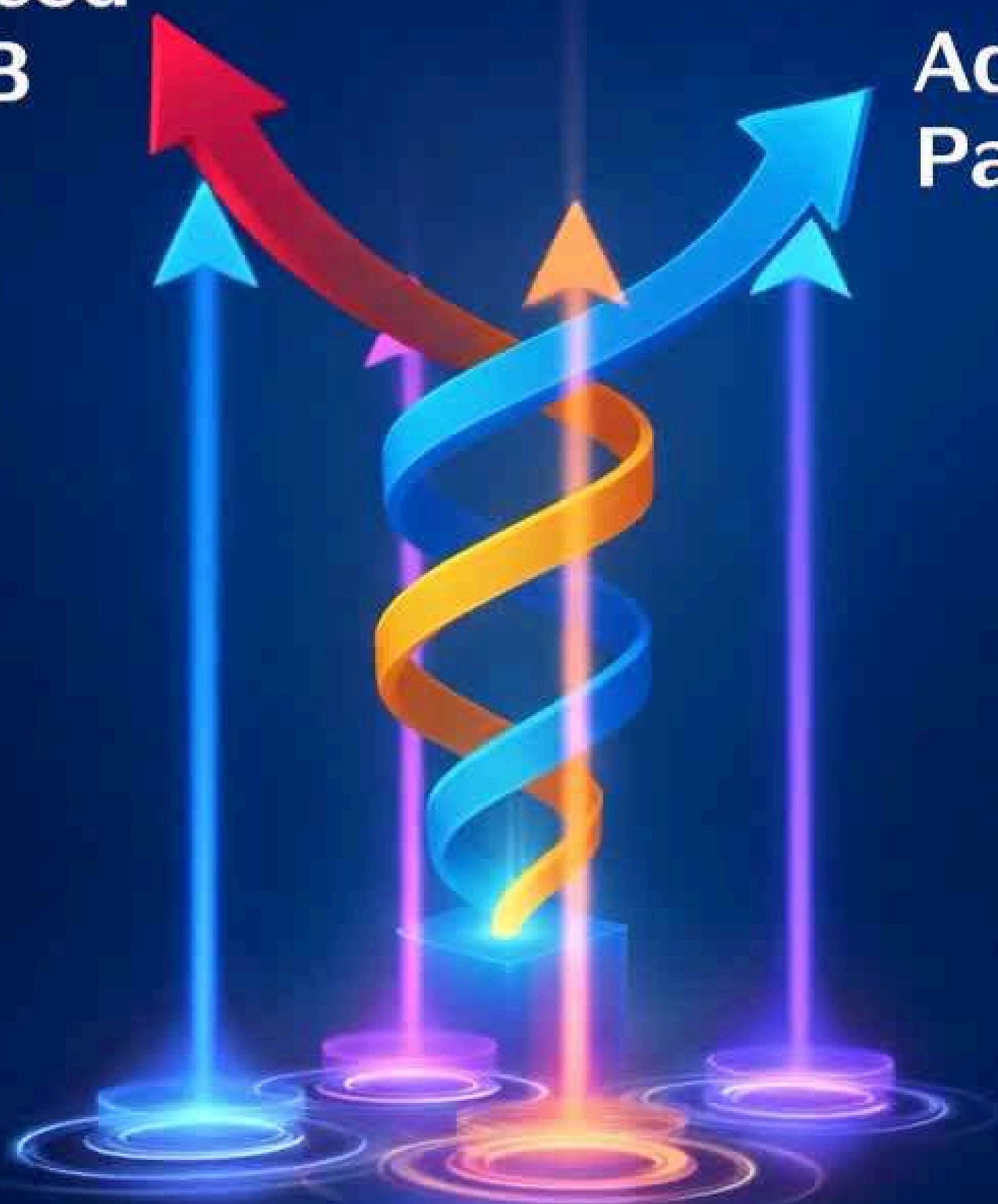
邊緣設備
人工智能

人工智能基礎建設



Advanced
PCB

Advanced
Packaging



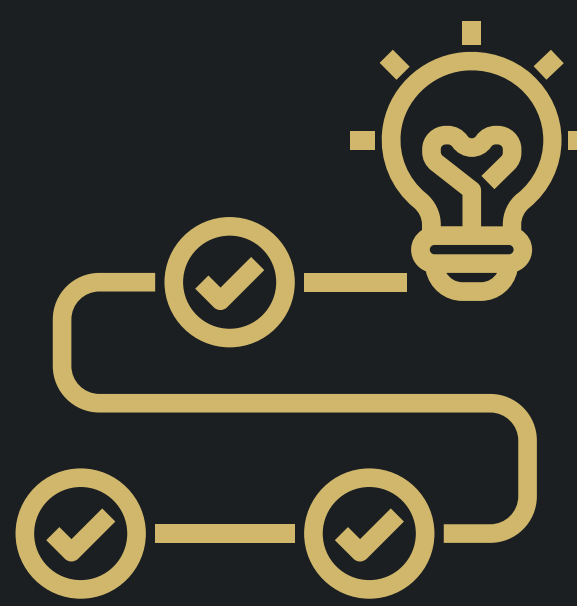
壓、貼、撕、烤
四大核心技術
驅動半導體xPCB產業



市場動能與資本支出 (CapEx) 放大效應

到2030年，全球人工智慧基礎設施總資本支出

巴克萊銀行 (Barclays) 修正後預測：超過 2 兆美元
每 1 吉瓦 (GW) AI 能源基礎設施 $\approx$ 投資額 500 至 600 億美元
OpenAI $\times$ Nvidia 10 GW 專案 = 約 5,000~6,000 億美元
OpenAI $\times$ AMD 6 GW 專案 = 約 3,000~3,600 億美元
OpenAI $\times$ Broadcom 10 GW 專案 = 約 5,000~6,000 億美元



這將為設備投資帶來指數級的倍增效應。

更多AI工廠



更多先進封裝產能



更新、更頻繁的更新
先進封裝製程與產能



激增的設備需求



晶圓代工 2.0

先進封裝

半導體 封測

IC載板 PCB

InFo

CoPoS

WMCM

SoIC

CoWoS

FoPLP

mSAP

SAP

FOCoS

HDI

CoWoS

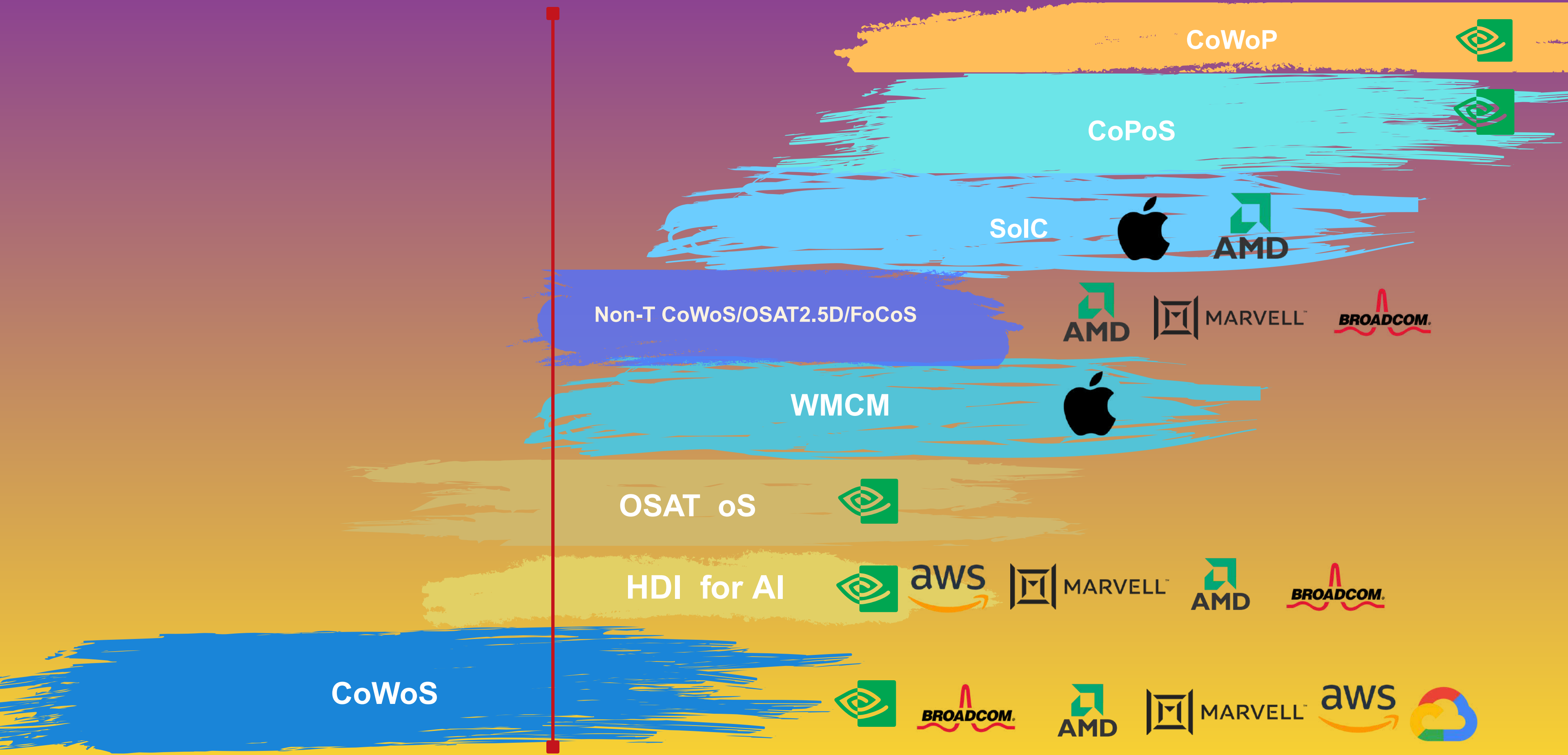
CoWoP

RDL

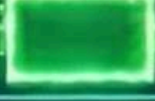
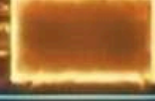
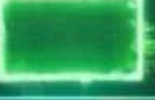
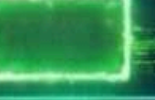
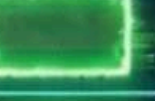
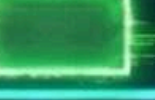
FlipChip

ABF

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030



先進封裝熱技術應用矩陣

熱技術應用 (Oven)	CoW (晶片對晶圓)	oS (晶片對基板)	OSAT oS	OSAT CoW	CoP (晶片對面板)
1. 清洗後烘乾 (Drying)					
2. 預固化 (Pre-Cure)					
3. 模塑固化 (Molding Cure)					
4. PI 固化 (PI Cure)					
5. PI 烘烤 (PI Bake)					
6. LTHC 烘烤 (LTHC Baking)					
7. 基板預烤 (Pre-Baking)					
8. 底部填充除泡 (De-Void)					
9. 散熱片烘烤 (Heat Sink Baking)					
10. BSM 固化 (BSM Curing)					
11. 去翹曲 (De-Warping)					
12. 退火 (Annealing)					



c sun

A **G2C+** Alliance Company

Thank you for your attention
